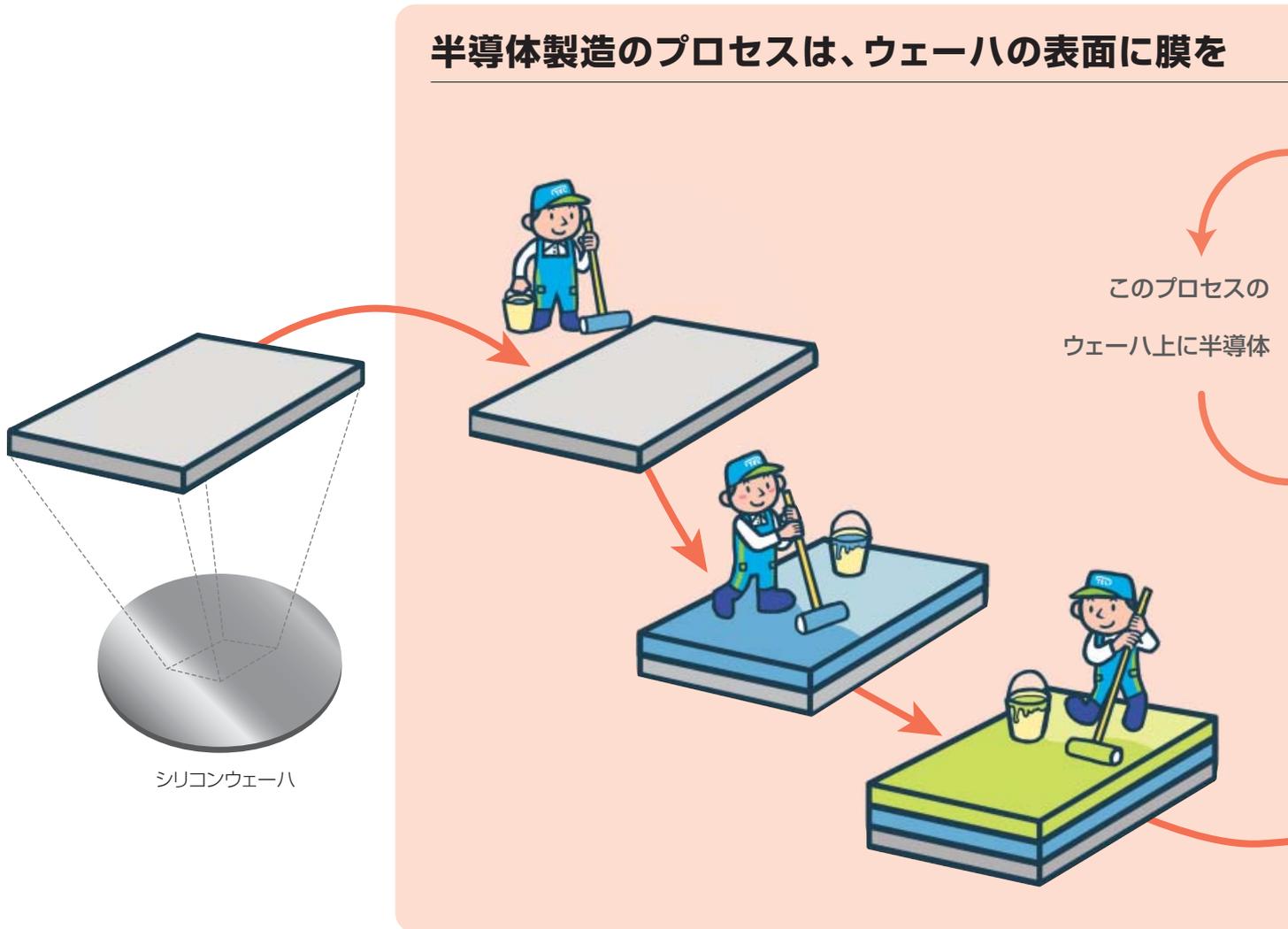


東京エレクトロンの製品

東京エレクトロンの製品のなかで、シリコンウェーハの表面を加工する工程を紹介します。



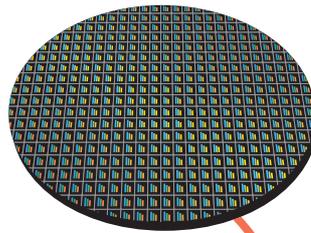
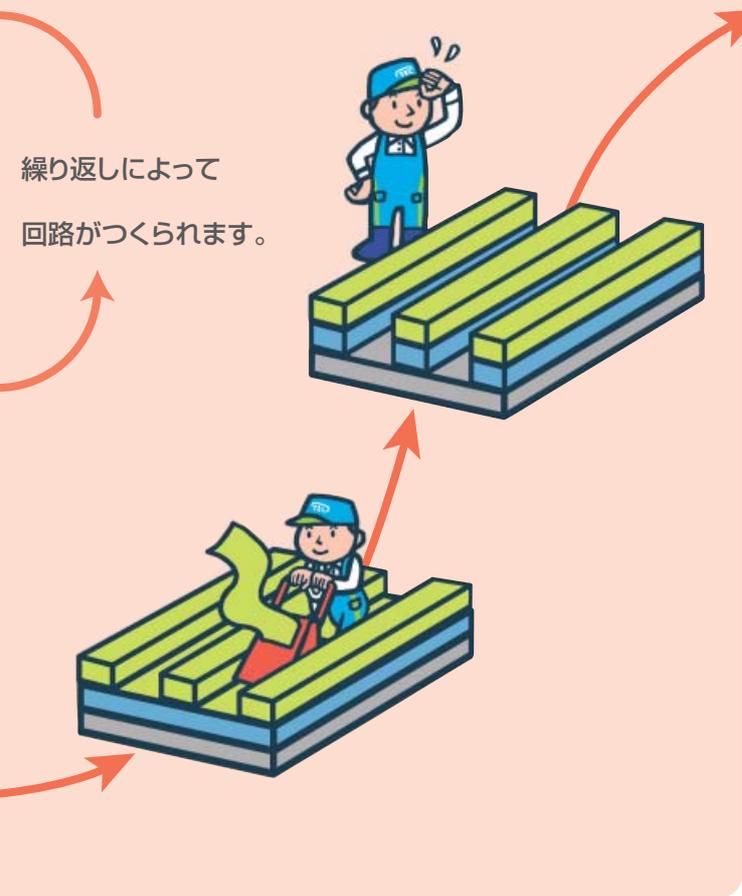
半導体のつくり方

半導体はシリコンウェーハと呼ばれる薄い円盤の上に、ガスや薬液を用いながら微細な回路を形成する工程を経て製造されます。酸化膜をつける（熱処理成膜装置）、感光剤（フォトレジスト）を塗る（コータ／デベロッパ）、フォトマスクを介してパターンを写す（露光装置）、プラズマを使って酸化膜を削り取る（プラズマエッチング装置）、その後、イオン注入、メタル成膜、ウェーハ検査が行われ加工は終了します。この後、ウェーハをカットし、配線・パッケージングを行うことで半導体が完成します。

ほかにはこんな仕事もしています

当社グループでは、半導体製造装置のほかにも、FPD（フラットパネルディスプレイ）をつくるための装置を開発・製造しています。また、半導体などの電子部品（東京エレクトロデバイス（株））およびインターネットテクノロジー機器（コンピュータ・ネットワーク事業部）のビジネスも当社グループの大きな事業の柱となっています。

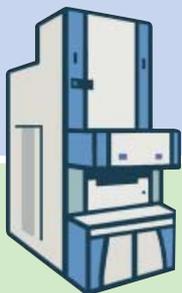
ついたり削ったりの繰り返しです。



これをカットして配線・パッケージングすると



半導体が完成します。



熱処理成膜装置



コータ/デベロッパ



プラズマエッチング装置

東京エレクトロンはウェーハの表面に膜をつけたり削ったりする様々な装置をつくっています。